

ECOREL™ SINTEC

Sinterlösungen der nächsten Generation

ANWENDUNGSBEREICHE

Sinterlösungen werden als Alternative zu Lötpaste bei Anwendungen eingesetzt, bei denen eine hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit, Zuverlässigkeit und mechanische Festigkeit entscheidend sind.

Zu den Schlüsselbereichen, in denen das Sintern bevorzugt eingesetzt wird, gehören bleifreies Die-Attach, großflächiges Modul-Attach, E-Fahrzeuge, Energieumwandlung von erneuerbaren Energien, Optoelektronik und RF-Leistungsbaulemente.

Insbesondere bei den neuesten SiC- und GaN-Entwicklungen, die mit viel höherer Leistung betrieben werden, ist die Verwendung von Sinterverbindungen mit höherer thermischer und ausgezeichneter elektrischer Leitfähigkeit entscheidend.

WEITERE VORTEILE

- Verarbeitung mit etabliertem Equipment
- Hohe Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit
- Niedriger elektrischer Widerstand ($3 \mu\Omega\cdot\text{cm}$)
- Keine CMR-haltigen Substanzen, kein Halogen und keine Nanopartikel
- RoHS-konform
- Zehnfache Verbesserung der Lebensdauer von Power-Modulen
- Weltweite Produktverfügbarkeit und technischer Support

HAUPTMERKMALE

1

Hohe Wärmeleitfähigkeit

ECOREL™ SINTEC-Sinterlösungen erreichen Wärmeleitfähigkeitswerte von über 300 W/mK, bieten eine außergewöhnliche Wärmeableitung und sind damit die ideale Wahl für Hochleistungsanwendungen.

2

Hohe Scherfestigkeit

Mit einer Scherfestigkeit von mehr als 50 MPa werden robuste Verbindungen gebildet, die es den Baugruppen ermöglichen, problemlos thermische Zyklastests (TCT) von -55°C bis +125°C für über 1000 Zyklen zu überstehen.

3

Lagerung bei Raumtemperatur

Die meisten Sinterpasten müssen gekühlt oder gefroren gelagert werden. Unsere Sinterlösungen können jedoch bei Raumtemperatur gelagert werden, was ihre Handhabung wesentlich erleichtert und dennoch eine Haltbarkeit von 6 Monaten gewährleistet.

4

Keine Nanopartikel

Im Gegensatz zu anderen auf dem Markt erhältlichen Sinterlösungen sind ECOREL™ SINTEC-Produkte frei von Nanopartikeln, was sie sowohl für den Anwender als auch für die Umwelt sicherer macht.

KONTAKTIEREN SIE UNS

Inventec Performance Chemicals HQ
26, Rue des coulons, 94363 Bry sur
Marne (Paris), France

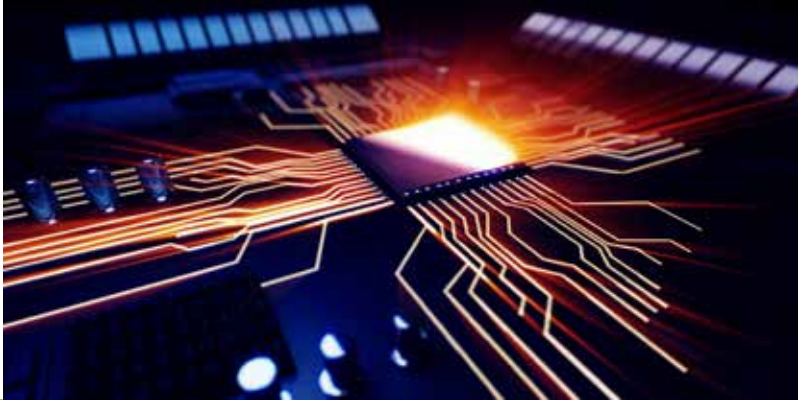
Tochtergesellschaften:
Spanien, Schweiz, Deutschland, Ungarn
China, Malaysia, Japan, Taiwan
USA, Mexiko

www.inventec.dehon.com
contact@inventec.dehon.com
+33 (0)1 43 98 75 00

WEBSEITE



Die Zukunft der elektronischen Montage durch Überwindung heutiger Grenzen



ALL-IN-ONE-SINTERPROZESS
Chip und substraten sintern in einem Schritt

Das All-in-One-Sinterverfahren hat das Potenzial, die Gesamtbetriebskosten für solche Anwendungen drastisch zu senken. Im Idealfall kann ein normalerweise aus zwei Schritten bestehender Prozess, Matrizen- und Substratsintern, zu einem einstufigen Prozess gemacht werden: Dies spart 50 % Energie, Verbrauchsmaterial und Zeit.

ECOREL™ SINTEC AP90 zeigt eine große Flexibilität von kleinen bis zu großen Oberflächenbereichen, aber auch für Material-Stapel, die beim Sintern und bei Belastungstests zum Verzug neigen.

ECOREL™ SINTEC
PRODUKTTREIHE

DRUCK

DRUCKEN

ECOREL™ SINTEC AP90

FLACHBETT-DOSIERUNG

ECOREL™ SINTEC AP90D

PROZESSMERKMALE

- Geeignet für Chip- und Modulbefestigung
- Kompatibel mit dem Sintern von Si-, SiC- und GaN-Chips
- Grundplatten >3000mm² möglich
- Niederdruck Sintern möglich
- All-in-One-Sintern möglich
- Sehr gute Benetzung auf Cu, Au, Ag & Ni

DRUCKLOS

DRUCKEN

ECOREL™ SINTEC XP95

DOSIERUNG

ECOREL™ SINTEC XP95D

PROZESSMERKMALE

- Geeignet für Die-Attach und Optoelektronik
- Chipgröße von max. 8x8mm möglich
- Verwendung in Standard-Reflowanlagen
- Sehr gute Benetzung auf Cu, Au & Ag

BASIEREND AUF **ngno-join** TECHNOLOGIE